PATENT ABSTRACTS OF AN

(11)Publication number:

11-058226

(43)Date of publication of application: 02.03.1999

(51)Int.CI.

B24B 37/04 H01L 21/304 H01L 21/304 H01L 21/304

(21)Application number: 09-237759

(22)Date of filing:

: 09-237759 18.08.1997 (71)Applicant:

EBARA CORP

(72)Inventor:

YOSHIDA MASAO

ATO KOJI

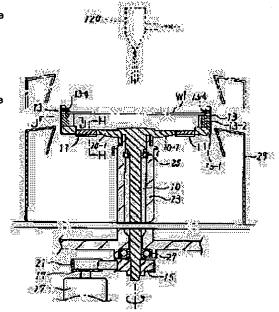
OIKAWA FUMITOSHI

(54) CHUCK WHEEL MECHANISM FOR WORKPIECE, POLISHING DEVICE, AND CLEANING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make the draft generated in the rotation flow in the specified direction.

SOLUTION: In a device, a plurality of arms 11 are radially projected from a rotational driving shaft 10, and a semiconductor wafer wf is turned by gripping the outer periphery by chuck parts 13 respectively provided on the arms 11. The arms 11 and the chuck parts 13 are formed into such a profile as to generate the down flow in which the draft to be generated in turning of the arms 11 is sucked from the outside of a chuck wheel mechanism to the rotational center side through the chuck parts 13.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

·(11)特許出願公開番号

特開平11-58226

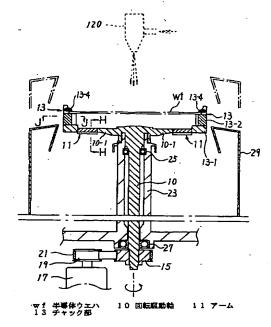
(43)公開日 平成11年(1999)3月2日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	FI		
B 2 4 B 37/04		B 2 4 B 37/04 E		
H01L 21/304	1 321	H01L 21/304 321A		
•	3 4 1	3 4 1 N		
	3 5 1	3 5 1 S		
		審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 7	7 頁)	
(21)出願番号	特願平9-237759	(71) 出願人 000000239		
		株式会社荏原製作所		
(22)出顧日	平成9年(1997)8月18日	東京都大田区羽田旭町11番1号		
		(72)発明者 吉田 正夫		
		東京都大田区羽田旭町11番1号 株式	(会社	
		荏原製作所内		
		(72)発明者 阿藤 浩司		
		東京都大田区羽田旭町11番1号 株式	t会社	
		在原製作所内		
	•	(72)発明者 及川 文利		
		東京都大田区羽田旭町11番1号 株式	(会社	
		荏原製作所内		
		(74)代理人 弁理士 熊谷 隆 (外1名)		

(54) 【発明の名称】 ワークのチャックホイル機構及びポリッシング装置及び洗浄装置

(57)【要約】

【課題】 回転時に生じる気流を所定の方向に向かせる ことのできるワークのチャックホイル機構を提供する。 【解決手段】 回転駆動軸10から複数本のアーム11を放射状に突出し、アーム11にそれぞれ設けたチャック部13にて半導体ウエハwfの外周を把持して旋回する構造である。アーム11とチャック部13は、アーム11の旋回時に生じる気流がチャックホイル機構の外部 からチャック部13を通して回転中心側に吸い寄せられた後にアーム11を通して下方に向かうダウンブローを 生じるような異形状に形成されている。



本発明のワークのチャックホイル機構の側断面図

【特許請求の範囲】

[請求項1] 回転駆動軸から複数本のアームを放射状に突出し、該アームにそれぞれ設けたチャック部にてワークを把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構において

前記複数本のアームの内少なくとも1つは、該アームの 旋回時に生じる気流がアームを通して下方に向かうダウ ンフローを生じる形状に形成されていることを特徴とす るワークのチャックホイル機構。

【請求項2】 回転駆動軸から複数本のアームを放射状 10 に突出し、該アームにそれぞれ設けたチャック部にてワークを把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構において、

前記チャック部の内の少なくとも1つは、該アームの旋回時に生じる気流がチャックホイル機構の外部からチャック部を通して回転中心側に吸い寄せられる形状に形成されていることを特徴とするワークのチャックホイル機構

【請求項3】 少なくともワークを保持するトップリングと、該トップリングに保持したワークの表面を研磨す 20る研磨面を有するターンテーブルと、研磨後のワークを回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワークを回転することでスピン乾燥するスピン乾燥機とを具備するボリッシング装置において、

前記洗浄機及び/又はスピン乾燥機のワークを支持及び 回転する手段に、請求項1又は2に記載のワークのチャックホイル機構を用いたことを特徴とするポリッシング ***

【請求項4】 ワークを回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワークを回転することでスピン乾燥するス 30 ピン乾燥機とを具備する洗浄装置において、

前記洗浄機及び/又はスピン乾燥機のワークを支持及び 回転する手段に、請求項1又は2に記載のワークのチャックホイル機構を用いたことを特徴とする洗浄装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野]本発明は、半導体ウエハ等の ワークのチャックホイル機構及びボリッシング装置及び 洗浄装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体ウエハの製造工程においては半導体ウエハ表面を鏡面化するポリッシング装置が使用されている。

[0003] ボリッシング装置はボリッシング部と洗浄 部とを具備し、ボリッシング部において研磨された半導体ウエハは洗浄部において洗浄された後、乾燥されて外部に取り出される。

[0004] そして洗浄部内に設置される半導体ウエハの洗浄機として、図8に示すように、回転駆動軸91から複数本のアーム93を放射状に突出してなるチャック

ホイル機構90の上に、ペンシル型洗浄部材100を設置して構成されるものがある。

【0005】即ちこの洗浄機においては、アーム93の 先端にそれぞれ設けたチャック部95にて円板形状の半 導体ウエハwfの外周を把持してこれを矢印A方向に旋回すると同時に、ペンシル型洗浄部材100の先端のスポンジ103を矢印B方向に回転しながらペンシル型洗浄部材100全体を矢印C方向に下降することで半導体ウエハwf上にスポンジ103を当接し、スポンジ103を支持するアーム105を矢印D方向に揺動させることで、スポンジ103を半導体ウエハwf全面に擦り合わせてゆくことで洗浄する。洗浄の際は洗浄液供給用ノズル107から洗浄液を供給する。

[0006] そして洗浄が終了すれば、ペンシル型洗浄部材100全体をC方向に上昇することで半導体ウエハwfから離し、アーム105を揺動することで半導体ウエハwfの上面から外に移動し、その後半導体ウエハwfは図示しないロボットのハンドによってチャック部95から取り上げられ、次の乾燥機に移送される。

【0007】乾燥機においても、図8に示すと同様のチャックホイル機構90が設置されており、このチャックホイル機構90にチャックされた半導体ウエハwfを高速回転することでスピン乾燥される。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来の洗浄機や乾燥機に用いられるチャックホイル機構90 にあっては、そのアーム93の横断面形状は矩形状になっているので、図9に示すチャックホイル機構90の概略側断面図のように、半導体ウエハwfの回転時に半導体ウエハwf下面にて矢印Eで示すような気流の乱れが生じてしまう。

[0009] 半導体ウェハ製造設備では、天井から床に向かってクリーンなエアをダウンフローさせることによって、室内のエアの清浄度を高めるように設計されているが、前述のように気流が乱れると、例えば矢印下で示すように、スピン乾燥機90の下側の清浄度の低いエアが巻き上げられ、該エアに含まれているパーティクルが半導体ウェハwfに付着する恐れが生じ、言い替えれば前記エアのダウンフローが有効に利用できないという問題点があった。

[0010] 本発明は上述の点に鑑みてなされたものでありその目的は、回転時に生じる気流を所定の一定方向に向かせることのできるワークのチャックホイル機構及びポリッシング装置及び洗浄装置を提供することにある

[0011]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するため本発明は、回転駆動軸から複数本のアームを放射状に 突出し、該アームにそれぞれ設けたチャック部にてワークを把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構に

3

おいて、前記複数本のアームの内少なくとも1つを、該 アームの旋回時に生じる気流がアームを通して下方に向 かうダウンフローを生じる形状に形成することとした。 また本発明は、回転駆動軸から複数本のアームを放射状 に突出し、該アームにそれぞれ設けたチャック部にてワ ークを把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構 において、前記チャック部の内の少なくとも1つを、該 アームの旋回時に生じる気流がチャックホイル機構の外 部からチャック部を通して回転中心側に吸い寄せられる 形状に形成することとした。また本発明は、少なくとも ワークを保持するトップリングと、該トップリングに保 持したワークの表面を研磨する研磨面を有するターンテ ーブルと、研磨後のワークを回転しながら洗浄する洗浄 機と、洗浄後のワークを回転することでスピン乾燥する スピン乾燥機とを具備するポリッシング装置において、 前記洗浄機及び/又はスピン乾燥機のワークを支持及び 回転する手段に、上記本発明にかかるワークのチャック ホイル機構を用いることとした。また本発明は、ワーク を回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワークを回 転することでスピン乾燥するスピン乾燥機とを具備する 洗浄装置において、前記洗浄機及び/又はスピン乾燥機 のワークを支持及び回転する手段に、上記本発明にかか るワークのチャックホイル機構を用いることとした。 [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。図6は本願発明を適用するポリッシング装置全体の内部構造を示す概略平面図である。同図に示すようにポリッシング装置はポリッシング部130と洗浄部150とによって構成されている。

【0013】ポリッシング部130はターンテーブル133の両側にトップリング135を取り付けたポリッシングユニット137と、ドレッシングツール139を取り付けたドレッシングユニット141とを設置し、さらにワーク受渡装置143を設置して構成されている。

【0014】洗浄部150は、中央に矢印乙方向に移動可能な2台の搬送ロボット151,153を設置し、その一方側に1次洗浄機50と2次洗浄機55と洗浄機能付きスピン乾燥機60とを並列に設置し、他方側に2台のワーク反転機161,163を並列に設置して構成されている。

【0015】とこで図1乃至図5は前記2次洗浄機55と洗浄機能付きスピン乾燥機60の両者にそれぞれ利用される本発明にかかるワークのチャックホイル機構を示す図であり、図1は概略側断面図(図2のX-X断面矢視図)、図2は概略平面図、図3は図1のH-H断面拡大図、図4は図1のJ-J断面拡大図、図5はアーム11とチャック部13の部分の要部拡大斜視図である。

【0016】図1. 図2に示すようにこのワークのチャックホイル機構は、回転駆動軸10の上端部から6本の 棒状のアームホルダー10-1を放射状に等間隔に突出 50

し、各アームホルダー10-1の先端にアーム11を放射状に突出するように取り付け、各アーム11の先端にチャック部13を設け、一方回転駆動軸10の下部に取り付けたプーリー15とモータ17に取り付けたプーリー19間にベルト21を巻き掛けて構成されている。

【0017】回転駆動軸10はシリンダ23内にボールベアリング25、27によって回転自在に軸支されており、またアーム11の外周にはこれを囲むように円筒状の液飛散防止用カバー29が設置されている。液飛散防止用カバー29は、ワークをチャック部13に対して搬入及び搬出させるための下降位置(図1中実線で示す)と、洗浄の際、外部に洗浄液を飛散させないための上昇位置(図1中、一点鎖線で示す)とに図示しない昇降機構により昇降できるように構成されている。

【0018】なお回転駆動軸10やシリンダ23などは何れも複数の部材を組み立てることで構成されているが、図ではこれを省略して一体のもののように記載している。

【0019】そして本発明においては、図3に示すよう に、アーム11の横断面形状と傾斜角度はアーム11旋回時、即ちアーム11が図3において矢印K方向に移動していく場合に、アーム11の下流側に形成される気流の方向Stと鉛直方向hとのなす角 θ hが、 θ h<90 となるように形成されている。つまり移動方向Kよりも下方向に向かう気流(ダウンフロー)が発生するような翼形状に形成されている。

【0020】なおアーム11は図5に示すように、その内部を貫通するアーム揺動軸11-1に取り付けられており、アーム揺動軸11-1の一端はアームホルダー10-1に取り付けられ、他端はチャック基部13-1を貫通してその先端をナット13-9で固定している。アーム11のアーム揺動軸11-1を中心とする揺動角度の調整は、ナット13-9を緩めて、アームホルダー10-1やチャック基部13-1に対してアーム11を揺動することで行なわれる。アーム揺動軸11-1やナット13-9はアーム11の揺動角度を調整してアーム11旋回時に生じる気流の方向を調整する気流調整手段である。

【0021】チャック部13は図5に示すように、チャック基部13-1の上面に、翼形状のチャック本体13-2をチャック基部13-1から垂直上方に向けて取り付けられたチャック本体揺動軸13-3に回動自在に軸支され、またチャック本体13-2の上面に立設した2枚のホルダー13-6の間に固定した回転軸13-5に把持爪13-4を取り付けて構成されている。

【0022】チャック本体13-2はチャック本体揺動軸13-3を回転中心軸として所定の角度に揺動せしめた状態で、チャック本体揺動軸13-3の上端にロックナット13-7を捩じ込むことによって固定される。チャック本体揺動軸13-3やロックナット13-7はチ

ャック本体 13-2の揺動角度を調整してチャック 13 旋回時に生じる気流の方向を調整する気流調整手段であ ス

[0023] 把持爪13-4は回転軸13-5の周りを図示しない機構によって回動することで、下記する半導体ウエハw f の外周を把持固定したり解除したりする。[0024] そしてチャック本体13-2 の横断面形状と傾斜角度は図4に示すように、チャック本体13-2 旋回時、即ちチャック本体13-2が図4において矢印 L方向に移動(回転)していく場合に、チャック本体13-2の下流側に形成される気流の方向S t と回転中心方向 r とのなす角 θ c が、 θ c $< 90^\circ$ となるように形成されている。つまり回転方向Lよりも回転中心方向 r 側に向かう気流が発生するような翼形状及び傾斜角度に

【0025】なお本実施形態では全てのアーム11及び チャック部13(チャック本体13-2)をそれぞれ翼 形状に形成し、それぞれ翼を同一方向を向くように配置 している。

形成されている。

[0026]なおこのワークのチャックホイル機構の上 20 部に図8に示す構造のベンシル型洗浄部材100(他の構造の洗浄部材でも良い)を設置すれば図6に示す2次洗浄機55が構成され、またこのワークのチャックホイル機構の上部に図1に点線で示すような液噴射洗浄用ノズル120(例えば後述するような洗浄液を噴射する構造を備えた洗浄ノズル)を設置すれば図6に示す洗浄機能付きスピン乾燥機60が構成される。

【0027】以上の構成からなるポリッシング装置の動作を説明すると、図6に示すようにまず研磨前の半導体ウエハWを収納したカセット165が図示する位置にセ 30ットされると搬送ロボット153が該カセット165から半導体ウエハwfを1枚ずつ取り出してワーク反転機163に渡して半導体ウエハwfを反転する。さらに該半導体ウエハwfはワーク反転機163から搬送ロボット151に渡されてポリッシング部130のワーク受渡装置143に搬送される。

[0028] ワーク受渡装置143上の半導体ウエハW fは矢印Pで示すように回動するボリッシングユニット 137のトップリング135下面に保持されてターンテーブル133上に移動され、回転する研磨面134上で 40 研磨され、その後再びワーク受渡装置143に戻される。

【0029】そして該半導体ウエハwfは搬送ロボット 151によってワーク反転機161に渡されて反転され た後、1次洗浄機50に移送され、1次洗浄機50に設 置された図示しないロール型ブラシ洗浄部材によって洗 浄される。

【0030】次に洗浄後の半導体ウエハwfは搬送ロボット151によって2次洗浄機55に移送され、図1に示すようにチャック部13の把持爪13-4とチャック 50

本体13-2の上面の間にチャックされる。次に液飛散防止用カバー29が図1の一点鎖線で示す位置に上昇する。次に図8に示すと同様のノズル107から洗浄液を半導体ウエハwf上に供給する。

【0031】そしてこの状態でモータ17を駆動すれば回転駆動軸10やアーム11と共に半導体ウエハwfが回転駆動される。

[0032] 同時に半導体ウエハwfの上部に設置された図8に示すと同様のペンシル型洗浄部材100によって半導体ウエハwfの表面が洗浄される。

【0033】前記洗浄の際、半導体ウエハw f の周囲の空間にはダストやミストが浮遊するが、本発明によれば前述のように、アーム11とチャック部13のチャック本体13-2とを所望の翼形状に形成したので、これらが旋回することによって図7に示すように、チャック部13ではチャックホイル機構の外部からチャック部13を通して回転中心側に吸い寄せられ、またアーム11ではアーム11を通して上から下に向けて気体が移動(ダウンフロー)するような一様な気流が発生して、天井から床に向かってダウンフローされるクリーンなエアの気流にマッチし、これによって洗浄後の半導体ウエハw f に前記ダストやミストが付着する恐れはなくなる。

【0034】次に図6に戻って2次洗浄機55で洗浄後の半導体ウエハwfは、搬送ロボット153によって洗浄機能付きスピン乾燥機60に移送される。前述のように洗浄機能付きスピン乾燥機60にも図1乃至図5に示すワークのチャックホイル機構が使用されているのでその動作を簡単に説明すると、半導体ウエハwfはチャック部13にチャックされて回転駆動され、同時に液噴射洗浄用ノズル120(図1参照)から超音波の振動エネルギーを与えられた洗浄液が噴射されるか、或いはキャビテーションを有する洗浄液が噴射されるか、或いはキャビテーションを有する洗浄液が噴射されるか、或いはキャビテーションを有する洗浄液が噴射されるか、或いはキャビデーションを有する洗浄液が噴射されるか、或いはキャビデーションを有する洗浄液が噴射されるか、或いはキャビデーションを有する洗浄液が噴射されるか、或いは浄され、洗浄後に回転駆動軸10をさらに高速回転するとで半導体ウエハwfのスピン乾燥を行なう。

[0035] この洗浄時及びスピン乾燥時においても、前記2次洗浄機55の場合と同様に、半導体ウエハwfの周囲の空間には図7に示すような上から下に向かう一様な気流、具体的にはチャックホイル機構の外側からチャック部13を通して回転中心側に吸い寄せられた後にアーム11を通して下方に向かうダウンフローが発生するので、天井から床に向かってダウンフローされるクリーンなエアの気流にマッチし、これによって半導体ウエハwfにダストやミストが付着する恐れはなくなる。

【0036】そしてスピン乾燥された半導体ウエハwfは、図6に示す搬送ロボット153によって元のカセット165に戻される。

[0037]以上本発明の実施形態を詳細に説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば以下のような種々の変形が可能である。

8

Φ上記実施形態は本発明をポリッシング装置の洗浄装置やスピン乾燥機として利用した例を示しているが、それ以外の各種半導体製造装置用のチャックホイル機構、又はさらにそれ以外の各種装置用のチャックホイル機構として利用できることは言うまでもない。その場合チャックするのは半導体ウエハ以外の各種ワークであってもよい。

【0038】②前記実施形態ではアームとチャック部の両者の横断面形状を、所定の気流発生用の形状に形成したが、何れか一方のみを所定の気流発生用の形状に形成しても良い。また複数あるアームの内の何れかのみ又は複数あるチャック部の内の何れかのみを所定の気流発生用の形状に形成しても良い。

【0039】③上記実施形態ではアーム及び/又はチャック部の横断面形状を、所定の気流発生用の翼形状に形成したが、必ずしも翼形状でなくても良く、例えば単に平板を斜めに傾斜して設置することで所定の気流を発生させるように構成しても良い。また翼形状のアーム11の下流側端部に図10に示すような上下に揺動可能なフラップ80を設けても良い。チャック部13のチャック本体13-2についても同様である。

【0040】②上記実施形態では気流の流れが下方向に一様に向かうようにアーム及び/又はチャック部の横断面形状を形成したが、取り付ける機器によっては該気流が上方向に一様に向かうようにアーム及び/又はチャック部の横断面形状を形成しても良い。

【0041】⑤上記実施形態ではアームとチャック部に これらの翼形状部分を揺動自在とする気流調整手段を設 けたが、これらを省略して一定の角度に翼形状を固定し ても良い。

【0042】**⑥**上記実施形態では、アーム、チャック自体を翼形状に形成したが、同様の効果を得るために、アーム、チャックのそれぞれ近傍に別部材で翼状や板状の気流生成手段を設けても良い。

[0043]

【発明の効果】以上詳細に説明したように本発明によれ*

*ば、回転駆動時に所望の一定方向の気流を発生させるととで回転駆動による気流の乱れを防止して一様な気流の流れを確保できるので、例えばクリーンルーム内のエアのダウンフローに準じた気流を発生することによって該エアのダウンフローを有効に利用して、チャックしたワークの品質向上などを図ることができるという優れた効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるワークのチャックホイル機構の の 概略側断面図である。

【図2】図1の概略平面図である。

【図3】図1のH-H断面拡大図である。

【図4】図1のJ-J断面拡大図である。

【図5】アーム11とチャック部13の要部拡大斜視図である。

【図6】本願発明を適用するポリッシング装置全体の内 部構造を示す概略平面図である。

【図7】本発明にかかるワークのチャックホイル機構の 気流の流れを示す図である。

20 【図8】従来の洗浄機を示す要部斜視図である。

【図9】従来のスピン乾燥機90の気流の流れを示す図 である。

【図10】他の構造のアーム11の断面図である。 【符号の説明】

wf 半導体ウエハ(ワーク)

10 回転駆動軸

11 アーム

13 チャック部

50 1次洗浄機

30 55 2次洗浄機

60 洗浄機能付きスピン乾燥機

130 ポリッシング部

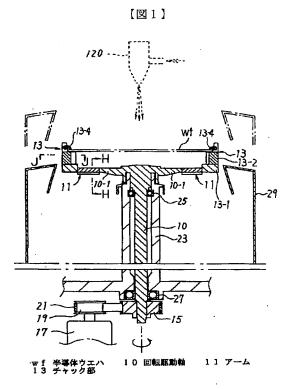
133 ターンテーブル

134 研磨面

135 トップリング

150 洗浄部

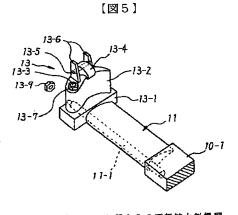
図1のJ-J断面拡大図



[図2]

本発明のワークのチャックホイル機構の概略平面図

本発明のワークのチャックホイル機構の側断面図



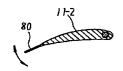
761 763 150 153 165 130 133 143 151

[図6]

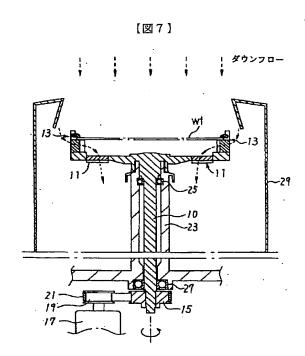
アーム11とチャック部13の要部拡大斜視図

ポリッシング装置の内部構造を示す図

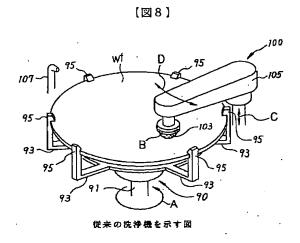
【図10】



他の構造のアーム 1 i - 2 の断面図



本発明のワークのチャックホイル機構の気流の流れを示す図



【公報種別】特許法第1.7条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第2部門第3区分

[発行日] 平成15年5月20日(2003.5.20)

【公開番号】特開平11-58226

[公開日] 平成11年3月2日(1999.3.2)

【年通号数】公開特許公報11-583

[出願番号] 特願平9-237759

【国際特許分類第7版】

B24B 37/04

H01L 21/304 321

341

351

[FI]

B24B 37/04 E

H01L 21/304 321 A

341 N

351 S

【手続補正書】

【提出日】平成15年2月5日(2003.2.5) 【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 回転駆動軸から複数本のアームを放射状 に突出し、該アームに設けたチャック部にてワークを把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構において、

前記複数本のアームの内少なくとも1つは、該アームの 旋回時に<u>一様な</u>気流を生じる形状に形成されていること を特徴とするワークのチャックホイル機構。

【請求項2】 回転駆動軸から複数本のアームを放射状に突出し、該アームに設けたチャック部にてワークを把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構において

前記チャック部の内の少なくとも1つは、該アームの旋回時に一様な気流を生じる形状に形成されていることを特徴とするワークのチャックホイル機構。

【請求項3】 少なくともワークを保持するトップリングと、該トップリングに保持したワークの表面を研磨する研磨面を有するターンテーブルと、研磨後のワークを回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワークを回転することでスピン乾燥するスピン乾燥機とを具備するボリッシング装置において、

前記洗浄機及び/又はスピン乾燥機のワークを支持及び 回転する手段に、請求項1又は2に記載のワークのチャックホイル機構を用いたことを特徴とするポリッシング

装置。

[請求項4] ワークを回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワークを回転することでスピン乾燥するスピン乾燥機とを具備する洗浄装置において、

前記洗浄機及び/又はスピン乾燥機のワークを支持及び 回転する手段に、請求項1又は2に記載のワークのチャックホイル機構を用いたことを特徴とする洗浄装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

[0011]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた め本発明は、回転駆動軸から複数本のアームを放射状に 突出し、該アームに設けたチャック部にてワークを把持 して旋回せしめる構造のチャックホイル機構において、 前記複数本のアームの内少なくとも1つを、該アームの 旋回時に一様な気流を生じる形状に形成することとし た。また本発明は、回転駆動軸から複数本のアームを放 射状に突出し、該アームに設けたチャック部にてワーク を把持して旋回せしめる構造のチャックホイル機構にお いて、前記チャック部の内の少なくとも1つを、該アー ムの旋回時に一様な気流を生じる形状に形成することと した。また本発明は、少なくともワークを保持するトッ プリングと、該トップリングに保持したワークの表面を 研磨する研磨面を有するターンテーブルと、研磨後のワ ークを回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワーク を回転することでスピン乾燥するスピン乾燥機とを具備 するポリッシング装置において、前記洗浄機及び/又は

特開平11-58226

スピン乾燥機のワークを支持及び回転する手段に、上記本発明にかかるワークのチャックホイル機構を用いることとした。また本発明は、ワークを回転しながら洗浄する洗浄機と、洗浄後のワークを回転することでスピン乾

燥するスピン乾燥機とを具備する洗浄装置において、前 記洗浄機及び/又はスピン乾燥機のワークを支持及び回 転する手段に、上記本発明にかかるワークのチャックホ イル機構を用いることとした。

THIS PAGE BLANK (USPTO)